

Title (en)  
BURN-IN PADS FOR TAB INTERCONNECT STRUCTURES.

Title (de)  
BURN-IN-ANSCHLUSSFLÄCHE FÜR AUTOMATISCHE BANDMONTAGESTRUKTUREN.

Title (fr)  
PASTILLES D'ESSAI DE VIEILLISSEMENT POUR STRUCTURES D'INTERCONNEXION A BONDERISATION AUTOMATIQUE A FILM.

Publication  
**EP 0364536 A1 19900425 (EN)**

Application  
**EP 89903601 A 19890314**

Priority  
US 17309488 A 19880328

Abstract (en)  
[origin: WO8909493A1] A tape automated bonding tape segment (10) carries on its top surface a printed circuit interconnect conductor high-density array (14) having a plurality of signal, power and ground conductors (16). Burn-in testing pads (40) are formed on either the top surface or the bottom surface of the tape segment, or both, and are connected to selected conductors. The testing pads are spaced apart and have a relatively low density to facilitate contact with test equipment, whereby a die connected to the printed circuit array can be tested.

Abstract (fr)  
Un segment de film (10) de bondérison automatique à film porte sur sa surface supérieure une matrice (14) à haute densité de conducteurs d'interconnexion de circuits imprimés qui comprend une pluralité de conducteurs (16) de signaux, d'alimentation et de mise à la terre. Des pastilles (40) pour essais de vieillissement sont agencées soit sur la surface supérieure soit sur la surface inférieure du segment de film, ou sur les deux surfaces, et sont connectées à des conducteurs sélectionnés. Les pastilles d'essai sont mutuellement espacées et présentent une densité relativement faible afin de faciliter le contact avec l'équipement d'essai, ce qui permet de tester un dé connecté au réseau de circuits imprimés.

IPC 1-7  
**H01L 21/66; H01L 23/50**

IPC 8 full level  
**G01R 31/26** (2006.01); **G01R 31/28** (2006.01); **H01L 21/60** (2006.01); **H01L 21/66** (2006.01); **H01L 23/495** (2006.01); **H01L 23/58** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**G01R 31/2863** (2013.01); **H01L 22/32** (2013.01); **H01L 23/49572** (2013.01); **H01L 24/50** (2013.01); **H01L 2924/14** (2013.01)

Citation (search report)  
See references of WO 8909493A1

Designated contracting state (EPC)  
DE FR GB

DOCDB simple family (publication)  
**WO 8909493 A1 19891005**; CA 1303752 C 19920616; EP 0364536 A1 19900425; JP H02500221 A 19900125

DOCDB simple family (application)  
**US 8900965 W 19890314**; CA 594187 A 19890320; EP 89903601 A 19890314; JP 50336689 A 19890314